

【ホツカイエムアイシー株式会社】

金属箔切断用のセラミックス製超精密カッターの開発

開発のねらい テーマである金属箔は電極箔のことであるが、この電極箔の材料として使用されているアルミ箔を切断するカッターについての開発テーマである。アルミ箔の切断を繰り返すとカッターに凝着が発生し、それが箔の切断面に悪い影響を及ぼす。このアルミの凝着を減らすのが、今回の開発のねらいである。

開発の概要

テーマであるセラミックス製カッターを製作するには、いくつかの課題を解決しなければならない。課題は以下のとおりである。

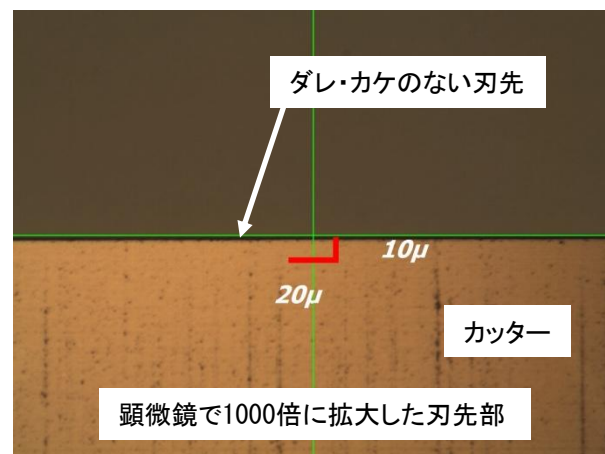
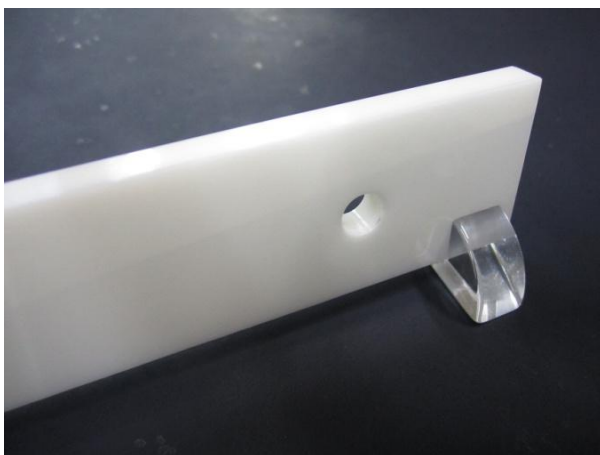
- ・カッターの刃部にダレ・カケを発生させない加工方法の確立
- ・1 μ mの加工精度
- ・測定方法の確立および製品保証

特長

セラミックスをカッターの素材としたのは、電極箔とセラミックスとの相性を考えた時、凝着が発生しにくいのではないかと推測したためである。セラミックスは非金属であるため、アルミの凝着は発生しにくいものとする。

用途

カッターは金属箔を切断するために用いられる。当社のカッターは箔を精密に切断するために用いられる。今回のテーマでの用途は電極箔の切断である。



お問い合わせ先

【所在地】 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-147

【連絡先】 TEL 048-665-6221 csg@hokkaimic.co.jp

